

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
参与单位	国投证券、山西证券、财通资本、草本投资、文浩私募、贵山私募、润义投资、昶元投资、崇盛投资、朝景投资、拓牌私募、磐鹰私募、融璇资产、安禅资产、义柏资本、全成私募、宁聚投资、杭金投资本、隼赐投资、同花顺
活动时间	2025 年 12 月 5 日
接待人员	董事会秘书王懿伟、大中华事业部负责人张巧其、财务副总监周星星、证券事务代表薛连科
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、董事会秘书王懿伟先生介绍公司概况并带领现场参观；</div> <div>二、董事会秘书王懿伟先生就公司主要产品及相关技术进行介绍；</div> <div>三、互动环节</div> <div>Q1 公司营业收入增速明显，但尚未扭亏为盈，请问公司未来业绩展望如何？</div> <div>答：公司 2024 年营收同比增长 51.38%，经营活动现金流净额 7,672.71 万元，2025 年前三季度营收同比增长 32.04%，经营活动现金流净额 9,745.25 万元，主要为半导体声光学、半导体封测等新产品放量交付影响。但由于新产品仍处于产能爬坡期，固定成本较高，同时公司为构建长期竞争力持续加大研发投入等原因，导致短期利润承压。2025 前</div>

三季度实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）8,079 万元左右。 目前研发成果已逐步显现，超声波指纹识别芯片声学层、图像传感器光路层、半导体工艺键合棱镜等产品已实现批量交付，MicroLED 已开始小批量生产和交付，非制冷红外芯片等已开始送样并得到客户认可，通过收购整合成功切入三星的客户供应链。公司现阶段研发内容主要包括：新一代半导体工艺键合棱镜、多通道光谱芯片光路层产品、超透镜（Metalens）、WLCSP 封装、射频滤波器 BAW 等。随着新开发产品的逐步量产、规模化效应释放及产能利用率提升，公司盈利能力有望逐步提升。

Q2 通过参观发现公司工艺平台很全面，请问公司 2026 年业务重心有哪些方向？

答： 公司专注于半导体声光学、半导体微纳电路（以 MEMS 为主）、半导体封测、精密光学、微纳光学等领域的研发与产业化。

2026 年公司的业务重心包括以下方面：

- 1、随着人形机器人及 AI 等领域的快速发展，MEMS 传感器的需求日益增加，公司将持续加大 MEMS 器件的研发投入与产能布局。2026 年，相关重点产品包括 MicroLED、非制冷红外传感器芯片等产品。
- 2、公司将继续深耕半导体与光学等交叉融合的创新赛道，持续巩固并扩大核心优势。2026 年，相关重点产品包括超声波指纹识别芯片声学层、图像传感器光路层、半导体工艺键合棱镜等产品。
- 3、公司坚定执行“国内深耕”与“海外拓展”并举的战略。通过收购越南工厂、设立韩国子公司，并与现有日本子公司协同联动，持续完善全球化产业布局。

Q3 我们看到了公司的核心产品有半导体声光学产品、半导体微纳电路产品、精密光学产品等，2026 年公司哪些产品会放量为公司带来收入增长？

答：1、随着超声波屏下指纹技术在手机市场的渗透率持续提升，公司作为核心供应商，该项业务有望在明年延续增长势头。

2、公司开发的半导体工艺键合棱镜已于 2025 年 10 月启动量产，目前产量正处于快速爬升阶段，预计 2026 年产能将进一步扩大。

3、公司在 MEMS 领域取得显著进展：MicroLED 产品已实现小批量交付，非制冷红外传感器产品亦获得客户积极反馈。这两款产品均有望在 2026 年实现产能放量。

Q4 刚刚参观看到公司已经量产的棱镜产品，请详细介绍下公司该产品的情况？

答：公司开发了业内首次应用于安卓手机的半导工艺键合棱镜。该技术通过半导体工艺精准控制低反低透膜尺寸，并借助特殊图形化设计，有效规避了传统开槽棱镜因界面粗糙导致的炫光与对比度下降问题，实现了优异的杂散光抑制效果。同时，其简化的结构减少了有害反射界面，使产品在光效、像质纯净度及稳定性方面均具备显著优势。目前，该棱镜产品已实现量产，产量正处于快速爬升阶段。与此同时，公司基于现有技术平台的迭代开发也已启动，新一代半导体工艺键合棱镜正在积极研发中。

Q5 请介绍下公司 MicroLED 项目进展情况，以及主要应用场景。

答：目前，公司该产品已与多家客户达成紧密合作，并实现小批量交付，产品主要面向 AR 眼镜、智能车载大灯等前沿应用领域。基于当前进展，公司有望在 2026 年实现规模化批量交付。

结束

附件 清单	无
----------	---